

Compression Molding System

Model CPM1080-HP



**New compression molding system achieving high precision
and high productivity for WLP/PLP molding processes**



用于实现PLP/WLP塑封工艺的高精度·高生产率的新型压缩成形设备

- 适用于HBM/2.5D/3D/Chiplet、FOWLP和PLP等先进封装
- 基于自主开发的压缩成形方式，实现晶圆级封装和面板级封装
- 可应对超薄和超厚产品的成形和MUF底部填充独特的颗粒树脂和液态树脂撒料机构
- 超凡的模具平整度和超高的真空度实现更高品质的生产
- 分离膜采用预切割方式，每次成形分离膜的使用量节省约25%（相比本公司之前工艺）
- 可通过增设或减少模组的方式灵活应对产能变化



SPECIFICATION

Items			Unit	Description			
机型			—	CPM1080-HP			
面板・晶圆类型			—	面板・晶圆			
面板・晶圆尺寸	面板		mm	□150—320mm			
	晶圆		mm	φ 320 (Max.)			
树脂			—	颗粒・液态			
机械时间			sec	Approximately 65			
外形尺寸	模组数量		module	1	2	3	4
	宽度		mm	5,490	6,170	6,850	7,530
	纵深		mm	2,168	2,168	2,168	2,168
	高度	顆粒樹脂規格	mm	1,980	1,980	1,980	1,980
		液态樹脂規格	mm	2,170	2,170	2,170	2,170
重量			ton	10.2	13.8	17.4	21.0
每模成形晶圆数量			workpiece	1	2	3	4
料盒放置空间			—	Panel : Input／Output 2 cassette each Wafer : 2 loadport			
合模压力			kN／(tf)	98.0—784.0／10.0—80.0			
合模速度			mm／sec	100 (Max.)			
使用分离膜的宽度			mm	440 (Max.)			
自选	Chip count		—	○			
	Package inspection		—	○			
	Package thickness measurement		—	○			
	After cure		—	○			
	Film handler		—	○			
	Substrate preheater		—	○			

- 以上数据为本公司标准机型时的规格
- 以上规格根据实际需要可能有改良变更的可能
- 如有其他特殊规格要求，另行协商



东和半导体设备（上海）有限公司

中国上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座20A
TEL 021-6888-6860

Website



Inquiry contact



TOWA（本公司商标），是TOWA株式会社的商标或注册商标。

Overseas Sales Contacts

Japan/Headquarters

TOWA Corporation

China

TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
TOWA Taiwan Co., Ltd.

Korea

TOWA Korea Co., Ltd.

Singapore

TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

Malaysia

TOWA MALAYSIA SALES
& SERVICES SDN. BHD.

Philippines

TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp.

Thailand

TOWA THAI COMPANY LIMITED

India

TOWA SEMICONDUCTOR INDIA
PRIVATE LIMITED

Germany

TOWA Europe GmbH

Netherlands

TOWA Europe B.V.

the United States

TOWA USA Corporation